

当社の豊富な知識と経験で部品のお困りごとをサポートします。

電子部品の真贋調査(比較観察)のご案内

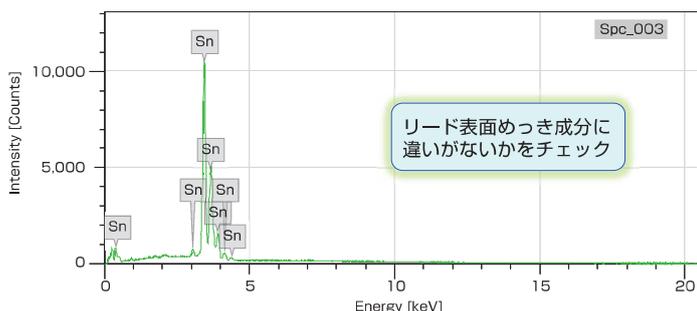
当社では、長年にわたり宇宙開発関連業務で培ってきた知識と経験で、お客様が使用される電子部品の真贋調査(比較観察)結果を提供いたします。

下記実施項目以外の項目も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

実施項目	注目する主なチェック事項
①外観観察	表示文字のフォント 表示文字の印字状態 モールド樹脂表面の追加工痕 リード追加工痕 寸法、質量
②X線透視観察	リードフレーム形状 内部寸法 ボンディングワイヤの種類
③電気特性測定	端子間特性(VIカーブ)
④成分分析	リード表面めっき成分 BGA(ボール)成分
⑤内部観察(破壊調査)	チップフェイスの形状 チップマーキング

※各実施項目は正規品との比較を実施

④成分分析



①外観観察

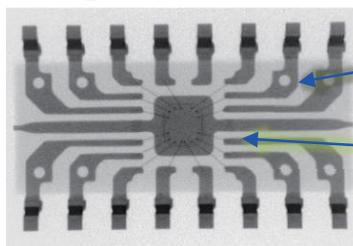


フォントや印字位置に違いがないかをチェック

モールド樹脂に追加工痕がないかをチェック

リードに追加工痕がないかをチェック

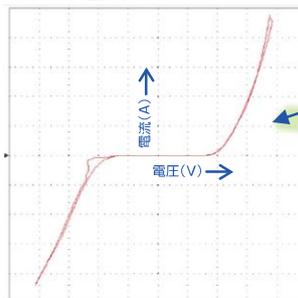
②X線透視観察



リードフレーム形状に違いがないかをチェック

ボンディングワイヤ形状に異常がないかをチェック

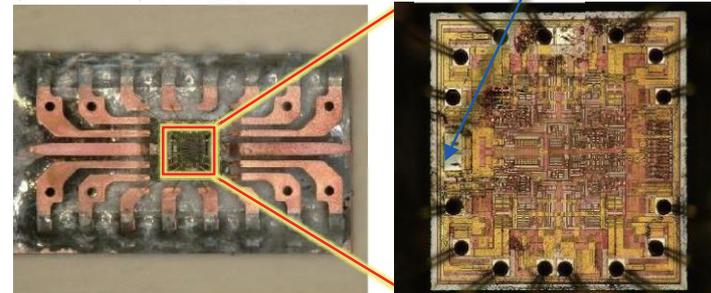
③電気特性測定



端子間特性(VIカーブ)に異常がないかをチェック

チップフェイス形状やチップマーキングの違いをチェック

⑤内部観察(破壊調査)



●詳細は、下記当社担当までお問い合わせください

